



# 平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成22年7月30日

上場会社名  東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035

URL <http://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 竹中 博司

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 小俣 良二

TEL : 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 平成22年8月10日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績(平成22年4月1日～平成22年6月30日)

### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期第1四半期	144,889	110.2	18,321	—	19,063	—	14,727	—
22年3月期第1四半期	68,915	△55.5	△14,388	—	△14,021	—	△11,035	—

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益	
	円	銭	円	銭
23年3月期第1四半期	82	27	82	12
22年3月期第1四半期	△61	66	—	—

### (2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円	銭	
23年3月期第1四半期	710,785	531,893	531,893	73.2	2,906	23		
22年3月期	696,351	523,369	523,369	73.5	2,859	37		

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 520,221 百万円 22年3月期 511,818 百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円	円	円	円	円
22年3月期	—	4 00	—	8 00	12 00
23年3月期	—				
23年3月期 (予想)		34 00	—	37 00	71 00

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 : 有

## 3. 平成23年3月期の連結業績予想(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
第2四半期(累計)	325,000	111.2	40,500	—	42,000	—	30,000	—	167	60
通期	670,000	60.0	86,500	—	88,000	—	63,000	—	351	95

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 : 有

4. その他 (詳細は、【添付資料】5ページ「2. その他の情報」をご覧ください。)

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 : 無

新規 一社 除外 一社

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : 有

(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 : 有

② ①以外の変更 : 無

(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期第1四半期 180,610,911株 22年3月期 180,610,911株

② 期末自己株式数 23年3月期第1四半期 1,608,496株 22年3月期 1,614,225株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期第1四半期 178,999,952株 22年3月期第1四半期 178,969,913株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】4ページ「1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 (3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

## 【添付資料】

## [目次]

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	4
2. その他の情報	5
(1) 重要な子会社の異動の概要	5
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要	5
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	5
3. 四半期連結財務諸表	6
(1) 四半期連結貸借対照表	6
(2) 四半期連結損益計算書(第1四半期連結累計期間)	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 継続企業の前提に関する注記	10
(5) セグメント情報	10
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10
4. 補足情報	11
(1) 生産、受注及び販売の状況	11

## 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間の世界経済は、ヨーロッパを中心とする金融市場の変動の深刻化や、信用収縮、雇用の悪化等の懸念はあるものの、各国の景気刺激策の効果や中国・インドを中心とする新興国の内需拡大に伴い、総じて緩やかな回復へ向かいました。また日本経済は、雇用情勢に厳しさが残るものの、輸出・生産の増加に支えられ着実に回復してきております。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業に関しましては、パソコンやデジタル家電、スマートフォンと呼ばれる高性能携帯電話の市場が急拡大しており、半導体・FPD関連市場の需要は旺盛になっております。

このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間の連結業績は、売上高1,448億8千9百万円(前年同期比110.2%増)、営業利益183億2千1百万円(前年同期は143億8千8百万円の営業損失)、経常利益190億6千3百万円(前年同期は140億2千1百万円の経常損失)、また、四半期純利益は147億2千7百万円(前年同期は110億3千5百万円の四半期純損失)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

#### ① 半導体製造装置

パソコン・デジタル家電・携帯端末向けの需要増加を背景に、半導体メーカー各社は増産を進め、設備投資を活発化させていることから、当セグメントの売上は順調に推移いたしました。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1,031億6千6百万円(前年同期比238.9%増)となりました。

#### ② FPD/PV (フラットパネルディスプレイ及び太陽電池) 製造装置

液晶テレビの普及拡大を背景に液晶パネルの需要が堅調に推移するなか、パネルメーカーによる増産や設備投資の再開により、当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、203億6百万円(前年同期比1.8%増)となりました。また、太陽電池製造装置分野につきましては、一時的に市場が減速しておりましたが、環境対策の世界的な広がりを背景に、今後の市場拡大が期待されます。

#### ③ 電子部品・情報通信機器

企業の生産活動が改善するとともに、産業機器向け半導体製品に対する需要回復が一段と鮮明になったことと、組み込み機器向けソフトウェアの販売やシステム関連の保守サービスが堅調に推移したことなどから、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、213億2千1百万円(前年同期比15.6%増)となりました。

#### ④ その他

当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、9千5百万円(前年同期比7.2%増)となりました。

※当第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。このため、各セグメントの外部顧客に対する売上高の前年同期との比較については、前第1四半期連結累計期間の数値を適用後の報告セグメントの区分に組み替えて算出しております。

(ご参考) 【連結】

(単位:百万円)

	当期第1Q	前期通期				
		前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	
売上高	144,889	418,636	68,915	84,975	114,289	150,456
半導体製造装置	103,166	262,391	30,437	51,699	76,511	103,743
日本	18,404	44,174	4,932	10,812	10,675	17,753
米国	17,552	55,555	12,430	8,364	13,273	21,487
欧州	2,942	10,937	2,833	2,315	2,433	3,355
韓国	21,445	44,716	2,861	8,823	13,391	19,640
台湾	34,014	76,795	5,917	16,619	27,913	26,344
中国	4,649	7,616	483	2,106	3,149	1,877
東南アジア他	4,158	22,595	979	2,656	5,675	13,283
FPD/PV製造装置	20,306	71,361	19,943	10,799	16,686	23,931
電子部品・情報通信機器	21,321	84,473	18,445	22,354	21,028	22,644
その他	95	410	89	121	63	136
営業利益(△損失)	18,321	△2,180	△14,388	△7,232	5,521	13,918
経常利益(△損失)	19,063	2,558	△14,021	△5,191	6,573	15,198
四半期(当期)純利益(△損失)	14,727	△9,033	△11,035	△5,125	△58	7,186

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

## ① 財政状態

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ162億5千2百万円増加の5,691億9千2百万円となりました。主な内容は、たな卸資産の増加129億6千4百万円、受取手形及び売掛金の増加54億3千6百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から4億7千2百万円減少し、916億5千5百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から2億4千4百万円減少し、53億4千1百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から11億2百万円減少し、445億9千6百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から144億3千3百万円増加の7,107億8千5百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ59億3千2百万円増加の1,250億9千4百万円となりました。主な内容は、前受金の増加69億2千7百万円であります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ2千2百万円減少の537億9千7百万円となりました。

純資産は、四半期純利益147億2千7百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当14億3千1百万円の実施による減少の結果、5,318億9千3百万円となり、また自己資本比率は73.2%となりました。

## ② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ7億8千2百万円増加し、1,247億2千1百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない預入期間3ヶ月超の定期預金及び譲渡性預金1,200億円を加えた残高は、2,447億2千1百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動により獲得したキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ45億7百万円減少の98億6千4百万円となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益192億5千万円、減価償却費37億2千6百万円、前受金の増加74億2千万円がキャッシュ・フローの収入となり、売上債権の増加67億8千6百万円、たな卸資産の増加144億9千万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出41億1千3百万円により、前年同期の53億7千2百万円に対し44億4千1百万円となりました。

財務活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主に短期借入金の純減少による支出21億6千7百万円、配当金の支払14億3千1百万円により、前年同期の10億2百万円に対し37億1千5百万円となりました。

## (3) 連結業績予想に関する定性的情報

今後の世界経済につきましては、欧米で一部懸念があるものの、アジアを中心に回復傾向が続くものと見られております。半導体関連市場につきましては、半導体需要が大幅に伸長し、半導体メーカーの設備投資も活発化しております。このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間において半導体製造装置事業の売上高及び利益が前回予想よりも増加する見込みとなったことにより、平成22年5月12日に公表した第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を以下のとおり修正いたします。

## 平成23年3月期の連結業績予想

	第2四半期連結累計期間	通 期
売上高	3,250億円 (前年同期比111.2%増)	6,700億円 (前年同期比60.0%増)
半導体製造装置	2,500億円 (前年同期比204.4%増)	5,110億円 (前年同期比94.7%増)
FPD/PV製造装置	320億円 (前年同期比 4.1%増)	690億円 (前年同期比 3.3%減)
電子部品・情報通信機器	430億円 (前年同期比 5.4%増)	900億円 (前年同期比 6.5%増)
営業利益	405億円	865億円
経常利益	420億円	880億円
当期(四半期)純利益	300億円	630億円

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通しに関する記載内容につきましては、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいております。

これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

## 2. その他の情報

### (1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

### (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

#### ① 簡便な会計処理

##### 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

#### ② 特有の会計処理

##### 税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。

### (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

#### 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成22年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	50,721	56,939
受取手形及び売掛金	129,898	124,462
有価証券	194,000	187,000
商品及び製品	92,809	87,201
仕掛品	44,186	37,793
原材料及び貯蔵品	14,418	13,455
その他	44,275	46,263
貸倒引当金	△1,118	△176
流動資産合計	569,192	552,939
固定資産		
有形固定資産	91,655	92,127
無形固定資産		
その他	5,341	5,586
無形固定資産合計	5,341	5,586
投資その他の資産		
その他	48,602	53,151
貸倒引当金	△4,006	△7,452
投資その他の資産合計	44,596	45,698
固定資産合計	141,593	143,412
資産合計	710,785	696,351
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	54,247	52,359
未払法人税等	8,134	4,355
その他の引当金	9,451	11,338
その他	53,259	51,109
流動負債合計	125,094	119,161
固定負債		
退職給付引当金	50,500	49,906
その他の引当金	611	621
その他	2,684	3,291
固定負債合計	53,797	53,820
負債合計	178,891	172,982



(単位：百万円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成22年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,023	78,034
利益剰余金	407,265	393,970
自己株式	△10,861	△10,900
株主資本合計	529,388	516,065
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	837	2,504
繰延ヘッジ損益	92	△67
為替換算調整勘定	△10,097	△6,683
評価・換算差額等合計	△9,166	△4,247
新株予約権	1,668	1,578
少数株主持分	10,004	9,973
純資産合計	531,893	523,369
負債純資産合計	710,785	696,351

## (2) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
売上高	68,915	144,889
売上原価	57,715	95,742
売上総利益	11,199	49,146
販売費及び一般管理費		
研究開発費	12,166	14,836
その他	13,421	15,988
販売費及び一般管理費合計	25,588	30,825
営業利益又は営業損失(△)	△14,388	18,321
営業外収益		
受取利息	281	155
補助金収入	380	474
その他	211	256
営業外収益合計	873	886
営業外費用		
為替差損	398	54
閉鎖拠点維持管理費用	—	56
その他	108	32
営業外費用合計	506	144
経常利益又は経常損失(△)	△14,021	19,063
特別利益		
貸倒引当金戻入額	—	310
固定資産売却益	1	—
その他	—	12
特別利益合計	1	322
特別損失		
固定資産除売却損	10	93
減損損失	4,375	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	42
特別損失合計	4,386	135
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△18,406	19,250
法人税等	△7,418	4,392
少数株主損益調整前四半期純利益	—	14,857
少数株主利益	48	130
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△11,035	14,727

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△18,406	19,250
減価償却費	4,913	3,726
減損損失	4,375	—
退職給付引当金の増減額(△は減少)	657	622
貸倒引当金の増減額(△は減少)	—	△2,333
賞与引当金の増減額(△は減少)	△2,566	△2,661
製品保証引当金の増減額(△は減少)	△1,026	722
受取利息及び受取配当金	△297	△172
売上債権の増減額(△は増加)	23,531	△6,786
たな卸資産の増減額(△は増加)	9,089	△14,490
仕入債務の増減額(△は減少)	△4,584	2,756
未収消費税等の増減額(△は増加)	10,315	6,513
前受金の増減額(△は減少)	△8,626	7,420
破産更生債権等の増減額(△は増加)	—	3,278
その他	△2,251	△3,125
小計	15,124	14,721
利息及び配当金の受取額	356	201
利息の支払額	△9	△9
法人税等の支払額	△1,099	△5,049
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,372	9,864
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	△3,665	—
有形固定資産の取得による支出	△1,331	△4,113
無形固定資産の取得による支出	△93	—
その他	△282	△328
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,372	△4,441
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△126	△2,167
配当金の支払額	△715	△1,431
その他	△159	△116
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,002	△3,715
現金及び現金同等物に係る換算差額	685	△925
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	8,682	782
現金及び現金同等物の期首残高	65,883	123,939
現金及び現金同等物の四半期末残高	74,566	124,721

## (4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## (5) セグメント情報

## ① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、B. U. (ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD/PV(フラットパネルディスプレイ及び太陽電池)製造装置」及び「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD/PV製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置及び薄膜シリコン太陽電池用のプラズマCVD装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「電子部品・情報通信機器」は、集積回路(IC)を中心とした半導体製品、その他電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等の設計・開発・仕入・販売等を行っております。

## ② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第1四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD/PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器				
売上高	103,166	20,306	21,500	3,692	148,666	△3,777	144,889
セグメント利益	22,314	2,787	412	629	26,143	△6,893	19,250

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの製品等の輸送、機器等のリース及び保険業務等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額△6,893百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△4,923百万円であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

## ③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

(追加情報)

当第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

## (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

## 4. 補足情報

## (1) 生産、受注及び販売の状況

## ① 生産実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 〔自平成21年4月1日 至平成21年6月30日〕	当第1四半期連結累計期間 〔自平成22年4月1日 至平成22年6月30日〕
	生産高	生産高
半導体製造装置	26,305	109,682
F P D / P V 製造装置	8,800	16,851
合計	35,105	126,534

(注) 1. 金額は販売価格によっております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## ② 受注実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 〔自平成21年4月1日 至平成21年6月30日〕		当第1四半期連結累計期間 〔自平成22年4月1日 至平成22年6月30日〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半導体製造装置	48,753	92,096	133,205	202,342
F P D / P V 製造装置	1,430	81,061	11,453	47,924
電子部品・情報通信機器	21,781	12,815	24,958	17,193
その他の	89	—	95	—
合計	72,054	185,972	169,712	267,460

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## ③ 販売実績

(単位：百万円)

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 〔自平成21年4月1日 至平成21年6月30日〕	当第1四半期連結累計期間 〔自平成22年4月1日 至平成22年6月30日〕
	販売高	販売高
半導体製造装置	30,437	103,166
F P D / P V 製造装置	19,943	20,306
電子部品・情報通信機器	18,445	21,321
その他の	89	95
合計	68,915	144,889

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

※当第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。このため、前年同期との比較については、前第1四半期連結累計期間の数値を適用後の報告セグメントの区分に組み替えて算出しております。